

2022年1月11日  
日本ファインセラミックス株式会社

## 昭和電工マテリアルズ株式会社 セラミックス事業の譲受に関する

### 契約締結のお知らせ

当社は今般、昭和電工マテリアルズ株式会社(取締役社長 高橋 秀仁、以下、昭和電工マテリアルズ)との間で、昭和電工マテリアルズのセラミックス事業(以下、本事業)譲受に関し、協議が合意に至り、2021年12月28日付で本事業の譲受に関する契約を締結しましたので、お知らせいたします。

#### 記

#### 1. 本事業譲受の理由

当社は、日揮ホールディングスグループの中期経営計画「BPS2025」の拡大重点戦略の一つである高機能材製造事業の一翼を担っており、一般産業機械、半導体・FPD製造装置用のセラミックスおよび金属複合材料(MMC)に加え、高速通信用薄膜回路基板を主力製品として製造・販売し、さらにパワー半導体用高熱伝導窒化ケイ素基板事業の拡大に取り組んでいます。

一方、昭和電工マテリアルズの本事業は、自動車、半導体および産業機械などの用途向けに、高密度炭化ケイ素(SiC)セラミックス、アルミナセラミックス、およびジルコニア強化アルミナセラミックスを提供しています。これらの製品は、各特性を生かして自動車エンジン冷却水ポンプシールや、半導体製造工程で用いる装置の精密位置決め部品などに採用されています。

当社は、将来に亘って持続的な成長を実現するための様々な選択肢の一つとして本事業譲受について鋭意検討した結果、自社が保有する非酸化物系セラミックスの材料・加工技術に、昭和電工マテリアルズの量産技術・材料技術を融合させることにより、半導体や次世代自動車等の成長分野における新製品開発の実現性が高まると判断し、本事業の譲受に関する契約締結を決定いたしました。

今後、昭和電工マテリアルズは、新たに設立する100%子会社(以下、新会社)に対し、2022年7月1日付で本事業を吸収分割の方法により承継させ、同日付で新会社の株式全てを当社が譲り受けることを予定しております。

## 2. 会社分割(吸収分割)の当事者の概要(2022年1月11日現在)

	吸収分割会社	新会社
(1) 名称	昭和電工マテリアルズ株式会社	未定
(2) 所在地	東京都千代田区丸の内一丁目 9番2号	未定
(3) 代表者の 役職・氏名	取締役社長 高橋 秀仁	未定
(4) 事業内容	機能材料及び先端部品・システムの製造・加工及び販売	セラミックス製品の製造・加工及び販売
(5) 資本金	154億54百万円	未定
(6) 設立年月日	1962年10月10日	2022年2月～3月 (予定)
(7) 大株主および 持株比率	HCホールディングス 株式会社 100%	昭和電工マテリアルズ 株式会社 100%

## 3. 株式譲受会社の概要(2022年1月11日現在)

(1) 名称	日本ファインセラミックス株式会社
(2) 所在地	宮城県仙台市泉区明通三丁目10番
(3) 代表者の役職・ 氏名	代表取締役社長 田中 宏
(4) 事業内容	炭化ケイ素や窒化ケイ素などのファインセラミックス、独自の金属セラミックス複合材料(MMC)、および薄膜集積回路を形成したセラミックス基板の製造販売
(5) 資本金	3億円
(6) 設立年月日	1984年4月
(7) 大株主および 持株比率	日揮ホールディングス株式会社 100%

## 4. 会社分割(吸収分割)及び株式譲受実行日

2022年7月1日(予定)